

Title (en)  
DEVICE FOR FLOWING THROUGH A COMPONENT OF AN AIR CONDITIONING SYSTEM OR A HEATING INSTALLATION, PROTECTIVE GRID AND HEAT PUMP OUTDOOR UNIT

Title (de)  
VORRICHTUNG ZUM DURCHSTRÖMEN EINER KOMPONENTE EINER KLIMAAANLAGE ODER EINER HEIZANLAGE, SCHUTZGITTER UND WÄRMEPUMPEN-AUSSENEINHEIT

Title (fr)  
DISPOSITIF PERMETTANT DE FAIRE CIRCULER UN COMPOSANT D'UNE INSTALLATION DE CLIMATISATION OU D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE, GRILLE DE PROTECTION ET UNITÉ EXTÉRIEURE DE POMPE À CHALEUR

Publication  
**EP 4050274 A1 20220831 (DE)**

Application  
**EP 22154849 A 20220202**

Priority  
DE 102021104615 A 20210226

Abstract (de)  
Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung (110) zum Durchströmen einer Komponente (100) einer Klimaanlage oder einer Heizanlage, insbesondere einer Wärmepumpen-Außeneinheit, mit einem Luftstrom (2), insbesondere zum freien Ausströmen eines Luftstroms (2) in eine Umgebung (1). Die Vorrichtung (110) umfasst einen, insbesondere in einer Hauptströmungsrichtung (3) im Wesentlichen konusförmig oder pyramidenförmig sich aufweitenden, Luftkanal (112) mit einer Luftkanalachse (113) und einer Mündung in die Umgebung (1), sowie ein quer zur Hauptströmungsrichtung (3) angeordnetes Schutzgitter (120) im Bereich der Mündung als luftdurchlässige Abdeckung des Luftkanals (112), insbesondere gegenüber der Umgebung (1), wobei das Schutzgitter (120) zumindest zwei im Wesentlichen koaxial zu und in unterschiedlichem senkrechten Abstand R von der Luftkanalachse (113) angeordnete, im Wesentlichen ringförmige Lamellen (122) aufweist. Es wird vorgeschlagen, dass Lamellenwinkel L der zumindest zwei Lamellen (122), gemessen zwischen einer jeweiligen Lamellenebene (123) und einer Mündungsebene, voneinander verschieden sind.

IPC 8 full level  
**F24F 1/56** (2011.01); **F04D 29/54** (2006.01); **F04D 29/70** (2006.01); **F24F 13/08** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**F04D 19/002** (2013.01); **F04D 29/541** (2013.01); **F04D 29/703** (2013.01); **F24F 1/56** (2013.01); **F24F 13/082** (2013.01)

Citation (search report)  
• [XYI] JP 2007139214 A 20070607 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD  
• [Y] WO 2013120623 A2 20130822 - ZIEHL ABEGG AG [DE]  
• [I] EP 2455617 A2 20120523 - EVG LUFTECHNIK GMBH [DE]

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 4050274 A1 20220831**; DE 102021104615 A1 20220901

DOCDB simple family (application)  
**EP 22154849 A 20220202**; DE 102021104615 A 20210226